



Seadra



2U1N2P

搭载第三代英特尔®至强®系列
可扩展处理器服务器系统

性能亮点

- 采用 OCP 3.0 实现极佳可扩展性，同时支持 6x PCIe Gen4 x16 插槽
- 高效双处理器，支持 TDP 高达 270W
- 2U 机箱内含 12 个 LFF/24 个 SFF HDD 盘位
- 采用模块化设计，具有良好的可服务性
- 显著降低 TCO

Seadra 是基于第三代英特尔®至强®系列可扩展处理器的高性能 2U 双路服务器，支持 TDP 高达 270W，存储容量可达 6TB。Seadra 具有 6x PCIe Gen4 x16 插槽和 1x OCP 3.0 插槽，不仅可提供高带宽网络通信功能，进而带来卓越的可扩展性和灵活性，还可显著降低其 TCO。作为用于数据推动型企业的稳固、高性能英特尔®平台，Seadra 非常适合各类虚拟化、超融合存储、云计算和高端企业服务器应用。

性能提升

最新第三代英特尔®至强®系列可扩展处理器提供行业领先工作负载优化型平台内置了 AI 加速（与上一代处理器相比，图像分类的 AI 训练性能提高 1.93 倍），由此提供的无缝性能基础可帮助加速从云端到智能边缘和后端的数据变革影响。此外，第三代英特尔®至强®系列可扩展处理器增强硬件安全性，可帮助阻止恶意利用数据，同时可使性能开销得到降低，保持工作负载完整性。可在闲置时、使用中以及飞行时提供具有高可用性和加密效率的信任服务交付。



虚拟化



超融合存储



云计算



高端企业服务器

正视图



后视图



在 2U 机箱内实现极佳的可扩展性和灵活性

采用的英特尔®C621A 芯片组支持双第三代英特尔®至强®系列可扩展处理器，DDR4 内存最高达 6TB，除支持英特尔®傲腾™持久内存之外，Seadra 还可提供 40 个内核，80 个线程和 32x DDR4 DIMM 插槽。内存子系统每个插槽包含 8 条通道以及 2 个 DPC。Seadra 还提供 PCIe Gen4 接口，最高可支持 100 GbE 网络，同时还提供 7 个 Slimline x8 PCIe 4.0 和 3x miniSAS (x4) SATA 3 用于存储，可实现高速连接功能，是高性能计算 (HPC) 应用的理想之选。此外，Seadra 的模块化前笼设计支持热插拔驱动，此设计提供从常规 SATA/SAS 盘位到最大 24x U.2 NVMe 驱动。结合两个内部 M.2 SATA 提供的 OS 驱动支持。Seadra 为包含内容加速在内的各类超融合存储场景做好了充分准备。

通过模块化设计实现可服务性和可靠性

Seadra 模块化设计提高可维护性，支持多种免工具操作可维护部件。此外，为进一步提升可靠性，Seadra 为电源和散热风扇提供 N+1 冗余。

英业达数据中心解决方案 (Inventec EBG)

英业达企业电脑事业群 (Inventec Enterprise Business Group) 成立于 1998 年，专注于服务器研发制造，“英业达数据中心解决方案”(Inventec Data Center Solutions) 传承英业达企业电脑事业群，专注于提供超大型数据中心、运算密集行业包括互联网以及电信运营商优秀解决方案。自成立以来，领先硬件研发制造能力深获全球领导服务器品牌、超大型数据中心及服务器硬件集成商等客户信任。

Seadra | 英特尔®至强®服务器

产品定位	通用
外形	2U1N2P 机架式 宽 x 高 x 深: 438 x 87.9 x 780 mm (17.24 x 3.46 x 30.71 英寸)
处理器	双插槽; 第三代英特尔®至强®系列可扩展处理器 TDP: 高达 270W
内存	32x DDR4 DIMM 插槽 每个 CPU 8 条通道, 共计 16 条通道 DIMM 类型: RDIMM、LRDIMM、3DS DIMM、BPS DIMM 3200 MT/s (2DPC) 支持英特尔®傲腾™持久内存
芯片组	英特尔®C621A
磁盘驱动器盘位	板载 2x SATA/PCIe (x1) M.2 前置主盘位: 12x 3.5" SAS/SATA/NVMe 热插拔驱动 (最多可达 16x 3.5" SATA) 或 24x 2.5" SAS/SATA/NVMe 热插拔驱动 后置盘位: 2x 2.5" SATA 热插拔驱动
扩展插槽	<p>SKU A</p> 4x PCIe Gen4 x16 (HHHL) + 1x PCIe Gen4 x16 (FHHL) + 2x SFF + 1x PCIe Gen4 x16 OCP 3.0 Mezz 插槽
SKU B	4x PCIe Gen4 x16 (FHFL) or (FHHL) + 1x PCIe Gen4 x16 (HHHL) + 1x PCIe Gen4 x16 (FHHL) + 2x SFF + 1x OCP 3.0 PCIe Gen4 x16 Mezz 插槽
SKU C	2x PCIe Gen4 x16 (FHFLDW) + 1x PCIe Gen4 x16 (HHHL) + 1x PCIe Gen4 x16 (FHHL) + 2x SFF + 1x PCIe Gen4 x16 OCP 3.0 Mezz 插槽
SKU D	后端支持 4x 3.5" SATA bays + 1x PCIe Gen4 x16 (HHHL) + 1x PCIe Gen4 x16 (FHHL) + 2x SFF + 1x PCIe Gen4 x16 OCP 3.0 Mezz 插槽
网卡控制器	可选 NIC 通过 OCP3.0 连接 10G/25G/100G NIC
存储控制器	支持 Raid/HBA 标准卡 板载 7x Slimline (x8) PCIe 4.0 3x miniSAS(x4) SATA 3
系统管理	专用 1x 100M/1GbE Base-T (AST2500)
TPM	TPM2.0 (可选)
电源	1+1 CRPS 电源 800W/1300W/1600W/ 2000W (110-220VAC), 白金
风扇	N+1 冗余, 6x 6056 热插拔风扇

英业达桃园科技园区 (Inventec TAO)

台湾桃园市桃园区大智路 88 号
Tel: 886-3-390-0000 Fax: 886-3-376-2370
Email: TAOproductsupport@inventec.com

更多产品信息请查询 <https://ebg.inventec.com/cn>

